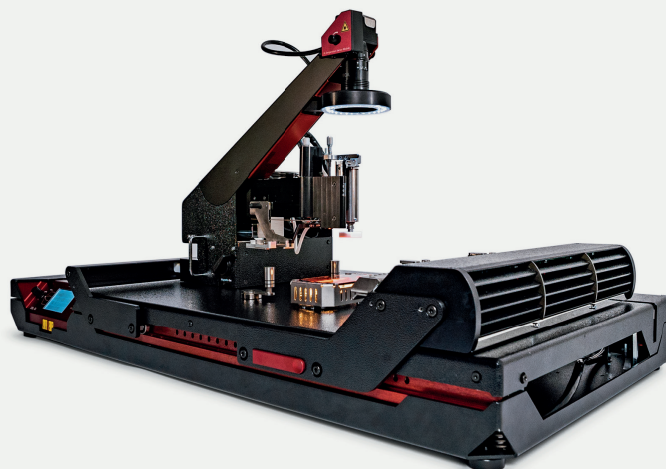


EXPERT 10.6 IV

Bewegliche 410 W Heizung

Reworkstation EXPERT 10.6 IV mit insgesamt 410W mit IR-Unterheizung (80 x 60 mm²) und automatisches Platzieren der SMDs mit Auto-Vision-Placer (AVP), inklusive EASYSOLDER 07 Softwarepaket und DBL 06 Steuergerät mit sechs hochauflösenden Temperatur-



messeingängen (Typ K). Dieses Gerät ist besonders geeignet zum Bearbeiten von kleinen Leiterplatten aus Smartphones oder PDAs mit Fine Pitch Komponenten unterschiedlichster Bauformen durch die flexible positionierbare Unterheizung.

Top Features

Kameragestütztes Rework



Flexibilität

verschiedene PCB Größen und Formen sowie Bauteile möglich



Unterheizung

flexibler Einsatz der Unterheizung, Applikation Mobiltelefone



Multifunktionalität

Alle Prozesse an einem Gerät: Lot Absaugen, autom. Positionierung, Löten und Entlöten



Prozesskontrolle

Automatischer Profiler für Unter- und Oberheizung



Software

einfach, intuitiv, Tablet kompatibel

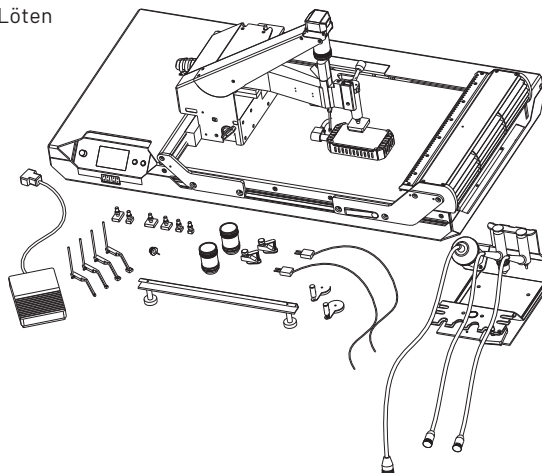


Präzision

Platziergenauigkeit bis 15 µm

Ausstattung

- Arbeitsgriffel mit Magazinständer für Dosieren, Bestücken, Altlotabsaugen und Löten
- Satz Bestück-Pipetten für BGA/CSP 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- Satz Löt-Werkzeuge (CSP/QFN), 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm
- Satz Löt-Werkzeuge (SO) 10x15mm², 15 x 25 mm²
- Bestück-Pipette zum manuellen Platzieren kleiner Bauteile (0,5mm)
- Zwei Objektive (BGA und CSP)
- Zwei Sensoren (Typ K) für Temperaturmessung
- Zwei Leiterplatten-Magnethalter 40,5 mm (Standard)
- LP-Anschlagschiene 40,5 mm
- Zwei Leiterplattenklammern zur Montage an der Handauflage
- Fußtaster
- Rework ABC und Betriebsanleitung
- Intuitive touchfähige Software EASYSOLDER 07



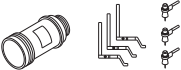
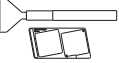
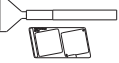
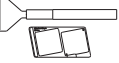
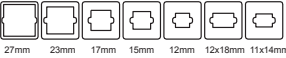
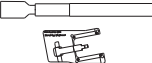
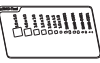
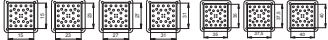
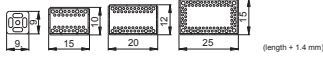
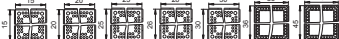
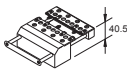
Technische Details

Gesamtleistungsaufnahme:	1000 VA
Leistung Lötgriffel:	300 W, 35 l/min
Leistung Unterheizung:	110 W 2 x IR-Lampen
Größe Unterheizung:	80 x 60 mm ²
Empf. max. Leiterplattengröße:	100 x 80 mm ²
Auflösung Positionierachsen:	0,001 mm
Platziergenauigkeit:	± 0,015 mm (Flip Chip)*
	± 0,030 mm (CSP)
	± 0,040 mm (BGA)

Hochaufl. CMOS-Kamera:	5 Mio. Pixel USB2
Bildausschnitt:	14 x 18 mm ² (Flip Chip)*
	28 x 37 mm ² (CSP)
	37 x 50 mm ² (BGA)
Elektrischer Anschluss:	1Phase, 230VAC, 25A Stecker CEE 32 A (3-phasig)
Druckluft:	5-8 bar, 100 l/min, gereinigte, trockene Luft
Systemabmessungen:	865 x 460 mm ²

*Ergänzungsbaustein

EXPERT 10.6 IV: Ergänzungsbausteine

	Artikel nr.	Name
	SF66.0004	Mikro-SMD-Ergänzung für AVP 4 Lizenz MS, 3 Pip, 3 Löt-Saug-D, Obj. FC
 Report	DVSX.0007	Report mit LP-Identifikation für ES-05, Lizenz RP
	SF71.0003	IR-Temperatursensor für AVP04.1
	SF64.0501	Tool Slider für AVP 4.1
	SF64.0525	Dipp Tool 32x0,08mm mit Rakel für Tool Slider
	SF64.0526	Dipp Tool 32x0,15mm mit Rakel für Tool Slider
	SF64.0527	Dipp Tool 32x0,22mm mit Rakel für Tool Slider
 27mm 23mm 17mm 15mm 12mm 12x18mm 11x14mm	AT10.0100	Chip Rahmen Set Dipp Tool 7 Stück (11x14,12x18,12,15,17,23,27)
	SF64.0520	Print Tool mit Rakel für Tool Slider
	SF64.0540	µSMD Tool für Tool Slider
 Maxi-BGA AVP4	SF66.0110	Objektiv Maxi-BGA für AVP4/4XL, f=16mm, 65*85mm
	LW40.1099	Löt-Werkzeug-Set BGA 7 für alle (98%) BGA-Typen, 7 Stück
 (length + 1.4 mm)	LW01.0400	Löt-Werkzeug-Set SO (bleifrei) für alle SO ...SOL ...TSOP, 4 Stück
	LW01.0100	Löt-Werkzeug-Set QFP für alle PLCC ...QFP, 7 Stück
	SF03.0019	Leiterplatten-Klemm-Halter 40,5 mit 3 Fingern für Handy-LPs HB-05/ IR/IRD/IRH/IRF/HIF
	SF71.0004	Seitenkamera (Objektiv 35mm) für ES-05, Kamera, Ständer, Kabel, DVD
	SF71.0007	Objektiv Seitenkamera f=16mm
	DB00.0025	Stickstoff-Anschluss DBL-04/05/06 (2.D.M) verringert N2-Verbrauch bei Vakuum

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.martin-smt.de